



深圳市鼎科实业有限公司

SHENZHEN TOP-TECH INDUSTRIAL CO., LTD.

P70-69TV60 研发新项目申请表

报告号

项目名称: BOE(深证) V69 极片开发

项目申请日期

2012. 10. 25

项目申请人(组) 张秋

项目编号:

编制日期:

市场现状分析及针对市场:

BOE 针对 32" 带 F-con 的屏有较大的用量, 故需为 BOE 开发一款 V69 的极片.

申请项目的特点:

见附见.

同立

钟振

各部门审核及建议:

业务部:

研发部:

生产部:

钟振

最终审核:

1. 四合一板子, 包含主板, 电源, LED 驱动, TCON, 主板芯片需要采用带 TCON 的 V69 芯片。 电源 90~240V 输入, 65W 以上左右, 待机功耗需要<0.5W.

功放功率 2*7W

2. 结构采用附件的结构, 下边两个螺丝孔和右上两个螺丝孔必须按照他们要求来, 左上角部分还可以变动, 包括板边也可以由我们定。

3. 端子: 1 路 USB, 一路 VGA, 一路 YPBPR 一路 AV 共声音, 一路耳机, 一路 ATV, 2 路 HDMI, 一路 AVOUT, 一路同轴用 2PIN 座子。

4. 时间: 11 月 22 号送出 3 至 5PCS 板子, 客户 12 号之前会提供屏给我们。 详细的时间见附件的表格。

5. 其他一些要求要注意: PCB 板子上的元件高度不能超过

13.5mm, 需要兼容双排针的 LVDS 座子和客户专用屏的 FFC 座子, FFC 座子上方要挖一个槽把 FFC 线从背面穿过。